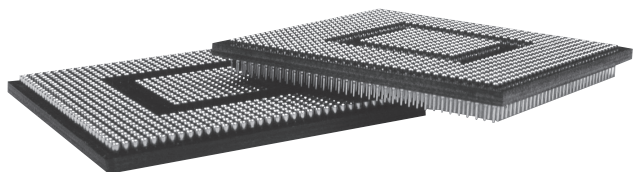


Giga-snaP™ (BGA SMTアダプタ)



Giga-snaP™アダプタ&ソケット

- 0.8mm, 1.0mm, 1.27mmピッチBGAに対応したGiga-snaP™は面実装アダプタを使用した安価で信頼性の高いソリューションをご提供します
- 製品は基板側に実装するSMTメスアダプタとBGAデバイスを実装するスルーホールオスソケットの組合せで構成されます。SMTメスアダプタ側にはBGAと同じハンダボールが付いています
- 0.8mmタイプは676ピンまで、1.0mmタイプは1936ピンまで、1.27mmタイプは1225ピンまで対応しています

特長: 熱に強く、軽い挿抜

特許出願中の特殊なオーバーモールド技術によりSMTメスアダプタは基板の熱膨張に追従するので、苛酷な環境などでの基板の熱膨張においてもハンダ付面のはく離などが起こりにくくなっています。さらにSMTメスアダプタは3回までのリフロープロセスに耐える事ができます。

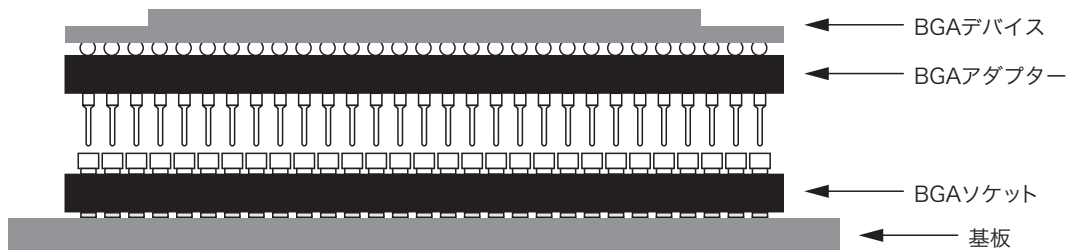
同様の方式の製品では基板側のメスアダプタとBGA取付け側のオスソケットの挿抜が問題になっていました。ピン数が多くなるほど基板にかかるストレスが高くなり、時には挿抜により基板のランドを傷めてしまう事もあります。一般的な1000ピンのデバイスを装着したアダプタの挿抜に要する力は356N(35.6kg)にもなります。

このGiga-snaP™は今までの同様の製品よりも更に低い挿抜力でアダプタとソケットの引抜が出来ます。例えば1000ピンのデバイス用の挿抜にかかる力は115N(約11.5kg)です。

高い接触信頼性

製品の信頼できるパフォーマンスを保障するものは機械的信頼性のみならず電気的接触の信頼性もそうです。Giga-snaP™はオスピンとメスソケットの接触ポイントの距離が4.5mmしかありません。これによりハイスピードなデバイスも問題なく機能します。

Giga-snaP™は全て自社内で製造されるので、非常に短納期にカスタムのレイアウトにも対応できます。



接続イメージ図

GHz QFNソケット

- GHz BGAソケットと同じ方式を採用したQFN(MLF, MLP,LPCC,QLP, HVQN,LFCSPとも呼ばれます)ソケットです。基本的な構造はGHz BGAソケットと同じ
- 0.4、0.5、0.65、0.8mmピッチに対応

